

「第10回 電子デバイスフォーラム京都」

アフターコロナ新時代の半導体/電子部品の飛躍戦略を探る!!

日時: 2023年10月23日(月)10:00~10月24日(火)17:30

場所: 京都リサーチパーク(KRP)東地区1号館、西地区4号館

主催: 一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)

特別協力: 電子デバイス産業新聞(株式会社産業タイムズ社)

後援(予定): 近畿経済産業局、京都府、京都市、SEMIジャパン

協賛(予定): IEEE関西支部、公益財団法人京都高度技術研究所

IEEE EDS 関西チャプター

【プログラム】(テーマ名等は今後変更の可能性あります)

【ウェルカム】: 10月23日(月)9:30~10:00 パンケットホール

【挨拶・基調講演】: 10月23日(月)10:00~13:00 パズホール

ご挨拶(予定): 西脇京都府知事、門川京都市長

基調講演: 関西でご活躍の企業、半導体の著名なアナリスト

・松波 弘之(京都大学 名誉教授)(予定)

・折井 靖光(Rapidus(株) 専務執行役員 3Dアセンブリ本部長)

・後藤 正人(株)SCREENセミコンダクターソリューションズ

代表取締役 社長執行役員)

・泉谷 渉(株)産業タイムズ社 代表取締役会長)

【マーケティングセッション】: 10月24日(火)9:20~11:45

サイエンスホール&(サテライト)G会議室

注目分野の著名なアナリストによる最新動向の説明

・中村 剛(株)産業タイムズ社)・南川 明 (OMDIA)・中根康夫(みずほ証券(株))

[Aコース: 環境・エネルギー]: 環境エネルギー動向、次世代モビリティ、パワーデバイスの最新動向

[Bコース: 新時代デジタル-量子の幕開け-]: 新時代デジタル動向、量子コンピュータ(最新動向)、量子コンピュータ(最新技術)

[Cコース: The 半導体]: 半導体の市場・技術動向、装置技術・プロセス技術、デバイス・応用

[Dコース: 跳躍の最先端パッケージ-実装技術] パッケージ-実装技術動向、シリコフオトニクス・コパッケージ・μLED、高密度実装

[Eコース: 特別セッション] 大学セッション(マテリアル先端リサーチインフラ)、ChatGPTの社会インパクト、中・韓・印の最前線を追う

【Web配信併用】: WEB配信を併用します。WEB配信は、在席で聴講でき、京都から遠い方にも、お忙しくて時間を取りにくい方にも便利で、お申込みセッションの予稿集は事前に送付します。

【レセプション】: アトリウムで10周年記念として鏡開き及び舞妓の舞も含めて実施予定です。有料セッションにご参加の方は無料で参加いただけます。レセプションのみご参加希望(参加費: 5000円)の場合は事務局に連絡ください。

【展示会】: ホワイエ及び中会議室Aで20ブースの展示会を開催します。(無料でご覧いただけます)

中会議室Aは「車載電子デバイスパビリオン」と位置付けて行います。

展示会への出展のご案内は、別途行なわせていただきます。

【参加費】

	一般	NEDIA会員 大学教職員	学生(WEB参加のみ)
1セッション	20,000(18,000)	17,000(15,300)	3,000(2,700)
1 Dayパス (10月23日)	30,000(27,000)	24,500(22,050)	4,000(3,600)
1 Dayパス (10月24日)	37,000(33,300)	29,500(26,550)	5,000(4,500)
2 Dayパス (10月23日、 10月24日)	49,500(44,550)	39,500(35,550)	7,000(6,300)

【事務局】(ご質問等は事務局に連絡ください)

一般社団法人日本電子デバイス産業協会事務局 周藤、堀

東京都千代田区神田佐久間町2-13竹内ビル202

TEL: 03-5823-4465 FAX: 03-5823-4475

E-mail: ddf.info@nedia.or.jp (第10回電子デバイスフォーラム京都専用のメールアドレスです)

【申込先】

参加の申込は、特設サイトからお願いいたします。(特設サイトは2023年8月上旬から開きます)

特設申込サイト: https://www.nedia.or.jp/ddf2023_entry/ 特設サイトは、NEDIA HP: <https://www.nedia.or.jp>からも入ることができます。

【組織委員会】

委員長: 齋藤昇三 (NEDIA代表理事・会長)

副委員長: 堀場 厚 (株)堀場製作所 代表取締役会長兼グループCEO)

副委員長: 中島規巨 (株)村田製作所 代表取締役社長)

副委員長: 後藤正人 (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ
代表取締役 社長執行役員)

副委員長: 松本 功 (ローム(株)代表取締役社長)

副委員長: 泉谷 渉 (NEDIA理事・副会長、(株)産業タイムズ社
代表取締役会長)

【プログラム委員会】

委員長: 中村 孝 (NEDIA理事、

ネクスファイ・テクノロジー(株)代表取締役、大阪大学教授)

	10月23日(月)	10月24日(火)
9:00		
10:00	ウェルカム	マーケティングセッション
	挨拶・基調講演	
13:00		
14:00	A-1~E-1セッション	A-2~E-2セッション
15:00		
17:00		A-3~E-3セッション
18:00	レセプション	
19:00		

・WEB併用の準備のため、WEB参加申込は10月13日までにお願いいたします。

・()内は早割価格です。

・早割価格は、9月22日までの申込に該当価格の10%割引価格を適用します。

・1セッションは、2日間のうちのいずれか1セッションの聴講ができます。

・1Dayパス(10月23日)は、10月23日(月)の挨拶・基調講演及びA-1~E-1セッション(どれか1セッション)の合計2セッションが聴講できます。

・1Dayパス(10月24日)は、10月24日(火)のマーケティングセッション、A-2~E-2(どれか1セッション)及びA-3~E-3(どれか1セッション)の合計3セッションが聴講できます。

・2Dayパスは、10月23日(月)の挨拶・基調講演 及びA-1~E-1セッション(どれか1セッション)、10月24日(火)のマーケティングセッション、A-2~E-2(どれか1セッション)及びA-3~E-3(どれか1セッション)の合計5セッションが聴講できます。

・上記は、会場参加及びWEB講演参加のどちらにも適用します。